

臨時報告書

本書は「金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項」および「企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 19 号」に基づく臨時報告書を、「金融商品取引法第 27 条の 30 の 2」に規定する開示用電子情報処理組織 (EDINET) を使用して、平成 21 年 6 月 23 日に提出したデータを出力・印刷したものであります。

大日本スクリーン製造株式会社

京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の 1

E 0 2 2 8 8

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年6月23日
【会社名】	大日本スクリーン製造株式会社
【英訳名】	DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 橋本 正博
【本店の所在の場所】	京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1
【電話番号】	京都 (075) 414-7155 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理戦略室長 巽 光司
【最寄りの連絡場所】	京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1
【電話番号】	京都 (075) 414-7155 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理戦略室長 巽 光司
【縦覧に供する場所】	大日本スクリーン製造株式会社東京支店 (東京都千代田区九段南2丁目3番14号靖国九段南ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

第69期(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)において、当社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該事象の発生日

平成21年6月23日(取締役会決議日)

(2) 当該事象の内容および連結損益に与える影響

当社は、平成21年6月23日開催の取締役会において、以下のとおり、関連会社である株式会社SOKUDO(以下SOKUDO社)の株式を取得し、同日付にて子会社化することを決議いたしました。

①株式の取得の理由

アプライドマテリアルズ社(Applied Materials, Inc.、本社米国カリフォルニア州、以下APPLIED社)と当社とのジョイントベンチャーによるSOKUDO社設立から約3年が経過いたしました。SOKUDO社は、当社から半導体関連コータ・デベロッパ(塗布現像装置)事業部門を分割・設立した会社であり、APPLIED社との業務・資本提携により、これまで共同支配企業として運営してまいりました。この間、SOKUDO社は、両社の強みを生かした新製品の開発を進め、平成21年4月に、高生産性を実現する世界初のデュアルトラックシステムを採用した次世代塗布現像装置「SOKUDO DUO」をリリースいたしました。

一方、半導体製造装置市場は、世界的な景気後退を受け低迷しており、当面厳しい状況が続くことが予想されます。このような環境のなか、SOKUDO社におきましても、海外拠点を含む、販売・サービス体制の適正化、効率化等、組織のスリム化が急務であるとともに、新製品のリリースを受け、よりフレキシブルに市場の要求に応えることのできる体制の確立が求められています。

かかる状況のなか、両社協議の結果、今後のSOKUDO社の事業価値向上、競争力強化のためには、当社の持つインフラの積極活用により規模の適正化を図るとともに、生産委託先である当社とのさらなる連携強化により従来以上にスピード感のある体制を確立していくことが不可欠と判断し、本件株式の取得(子会社化)を実施するものであります。

なお、今回の株式取得により、SOKUDO社の株主構成は当社81.0%、APPLIED社19.0%(従来は当社52.0%、APPLIED社48.0%)となります。

②株式会社SOKUDOの概要

(イ) 名称	株式会社SOKUDO	
(ロ) 所在地	京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町88番地 K・I 四条ビル	
(ハ) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 須原 忠浩	
(ニ) 事業内容	半導体関連コータ・デベロッパに関する開発、製造、販売、保守事業	
(ホ) 資本金	90百万円	
(ヘ) 設立年月日	平成18年7月3日	
(ト) 大株主及び持株比率	大日本スクリーン製造株式会社 52.0% Applied Materials, Inc. 48.0%	
(チ) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当該会社は当社およびApplied Materials社による共同支配企業であり、当社は当該会社の発行済株式総数の52.0%を保有しております。
	人的関係	平成21年4月1日現在、当社は当該会社に対し、代表取締役社長(非常勤)および取締役2名(非常勤)ならびに監査役1名(非常勤)を派遣しております。また、当該会社の従業員のうち、119名が当社からの出向社員であります。
	取引関係	当社は当該会社から半導体関連コータ・デベロッパの生産を受託しております。

(リ) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成19年3月期 (9ヶ月)	平成20年3月期	平成21年3月期
連結純資産	23,737百万円	16,195百万円	4,505百万円
連結総資産	38,551百万円	28,608百万円	12,952百万円
連結売上高	23,144百万円	22,555百万円	12,264百万円
連結当期純利益	△1,975百万円	△7,602百万円	△11,687百万円

③Applied Materials社（株式取得の相手先）の概要

(イ) 名称	Applied Materials, Inc.
(ロ) 所在地	3050 Bowers Avenue, Santa Clara, California 95054 United States of America
(ハ) 代表者の役職・氏名	Michael R. Splinter (Chairman of the Board, President and CEO)
(ニ) 事業内容	半導体、フラットパネル、太陽電池関連市場に製造装置、サービス、ソフトウェア製品などNanomanufacturing Technology™ ソリューションを幅広く提供
(ホ) 設立年月日	1967年11月10日
(ヘ) 株主資本	7,095,899千米ドル（2009年4月26日現在のTotal stockholders' equity）
(ト) 総資産	9,749,099千米ドル（2009年4月26日現在）
(チ) 大株主及び持株比率	FMR LLC 15.0%（2009年2月17日現在） Capital World Investors 9.1%（2009年2月13日現在）
(リ) 上場会社と当該会社の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的・資本関係等はありません。

④取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

(イ) 異動前の所有株式数	520株（所有割合：52.0%）
(ロ) 取得株式数	290株
(ハ) 異動後の所有株式数	810株（所有割合：81.0%）

⑤日程

(イ) 取締役会決議	平成21年6月23日
(ロ) 株式取得日	平成21年6月23日

⑥連結損益に与える影響

本件、株式取得により、SOKUDO社は共同支配企業（持分法に準じた会計処理適用の関連会社）から当社の子会社となるため、SOKUDO社およびその100%子会社SOKUDO USA, LLCの2社を新たに連結の範囲に含める予定です。

また、当社は、改正後の企業結合に関する会計基準等を平成22年3月期より適用し、本件SOKUDO社の連結子会社化に際し、約52億円の特別利益（段階取得に係る差益ならびに負ののれん発生益）を計上する予定です。

以上